

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-038

## 成都天箭科技股份有限公司

### 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、基本情况

为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行各申请综合授信额度人民币壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为十二个月。

董事会授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。

本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、备查文件

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日